



横浜国大 シーマ電子

同プロジェクトに格といえる企業だ。

は、住友ベークライト 大電流が流れるパワ
やDICなど大手材料 デバイスでSiCの
メーカー約20社が、計 高耐熱性を生かすに
年約3000万円を出は、実装で使う金属、
資。金型や評価装置を 無機、高分子の各材料
手がける中小企業など の信頼性が重要だ。プ
10社弱が試作や評価に ロジエクトでは候補の
携わる。半導体パッケ 材料を使ってデバイス
電子(横浜市中区)は 下させて耐久性を調べ
試作に関連した高い技 術を保有しており、プ
ロジェクトのリーダー 大の高橋昭雄客員教授



多様なメンバ 前、横浜国大の半導体
ーがコンソー シアの魅力
(左端が高橋 ぶれにひかれて加わっ
客員教授、右 た。KAMOMEプロ
端が吉田取締役 エクトはこから立
ち上がり、メモリーな
ど汎用の半導体の次、

は「大企業の場合、事 業部の製中とそれに使
う材料の開発部が連動 シーマ電子は約10年
は「大企業の場合、事 業部の製中とそれに使
た」と説明する。

SiCモジュール 高耐熱性調査

が得られるのが魅力」
と強調。産産連携の
効果も得ている。

(木曜日に掲載)

省エネルギーのパワ
ーデバイスとして、高
級自動車などに使われ
る炭化ケイ素(SiC)
半導体。横浜国立大学
はSiCモジュール実
装材料の評価を行う
「KAMOMEプロジ
エクト」に2011年
から取り組んでいる。